



平成 18年 3月期 第 1四半期業績の概況 (連結)

平成 17年 7月 19日

上場会社名 株式会社 図 研

(コード番号 : 6947 東証第 1部)

(URL <http://www.zuken.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 金子 真人

問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 西 伸孝

TEL (045) 942 - 1511

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

売上高の会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

2. 平成18年 3月期第 1四半期業績の概況 (平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17年 6月 30日)

(1)連結売上高 (又はこれに相当する事項) (単位 百万円未満切捨)

期	項目	売上高	
		百万円	%
平成18年3月期第 1四半期		3,235	1.6
平成17年3月期第 1四半期		3,183	1.8
(参考)17年3月期		15,769	2.6

(注)売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

(参考)販売及び受注の状況

売上高

(単位 百万円未満切捨)

期 別 品 目 別	平成18年3月期第 1四半期 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年6月30日〕		平成17年3月期第 1四半期 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年6月30日〕	
	金額	構成比率	金額	構成比率
基板設計ソリューション	1,090	33.7	1,268	39.8
回路設計・ICソリューション	598	18.5	508	16.0
ITソリューション	286	8.9	193	6.1
クライアントサービス	1,249	38.6	1,206	37.9
その他の	9	0.3	6	0.2
合計	3,235	100.0	3,183	100.0

受注高及び受注残高

(単位 百万円未満切捨)

期 別 品 目 別	平成18年3月期第 1四半期 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年6月30日〕		平成17年3月期第 1四半期 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年6月30日〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	1,029	428	1,415	628
回路設計・ICソリューション	846	432	742	429
ITソリューション	540	444	468	409
クライアントサービス	1,826	2,517	1,604	2,273
その他の	14	6	13	8
合計	4,256	3,829	4,245	3,748

[売上高に関する補足説明]

当第1四半期の経済環境は、企業収益に改善が見られ、民間設備投資が増加するなど景気は緩やかな回復基調にありましたが、米国や中国に対する輸出の減速や原油価格の高止まりなどから、景気の先行きに対する不透明感を払拭しきれない状況が続いております。

このような中で当社グループは、エレクトロニクス分野における設計・製造プロセス全体の効率化というお客さまのかかえる課題の解決に向けたソリューションビジネスを積極的に推進してまいりました。

その結果、基板設計ソリューションにおいてビジネスサイクルの長期化などにより売上が減少したものの、回路設計・ICソリューション、ITソリューション、クライアントサービスにおいては売上高、受注高とも順調に推移し、当第1四半期の連結売上高は、32億3千5百万円(前年同期比1.6%増)となりました。

(2)当該四半期において企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与えた事象

該当する事象は特に発生しておりません。

3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
中間期	8,000	770	470	16	85
通期	17,400	2,350	1,580	56	63

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年5月16日公表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以上